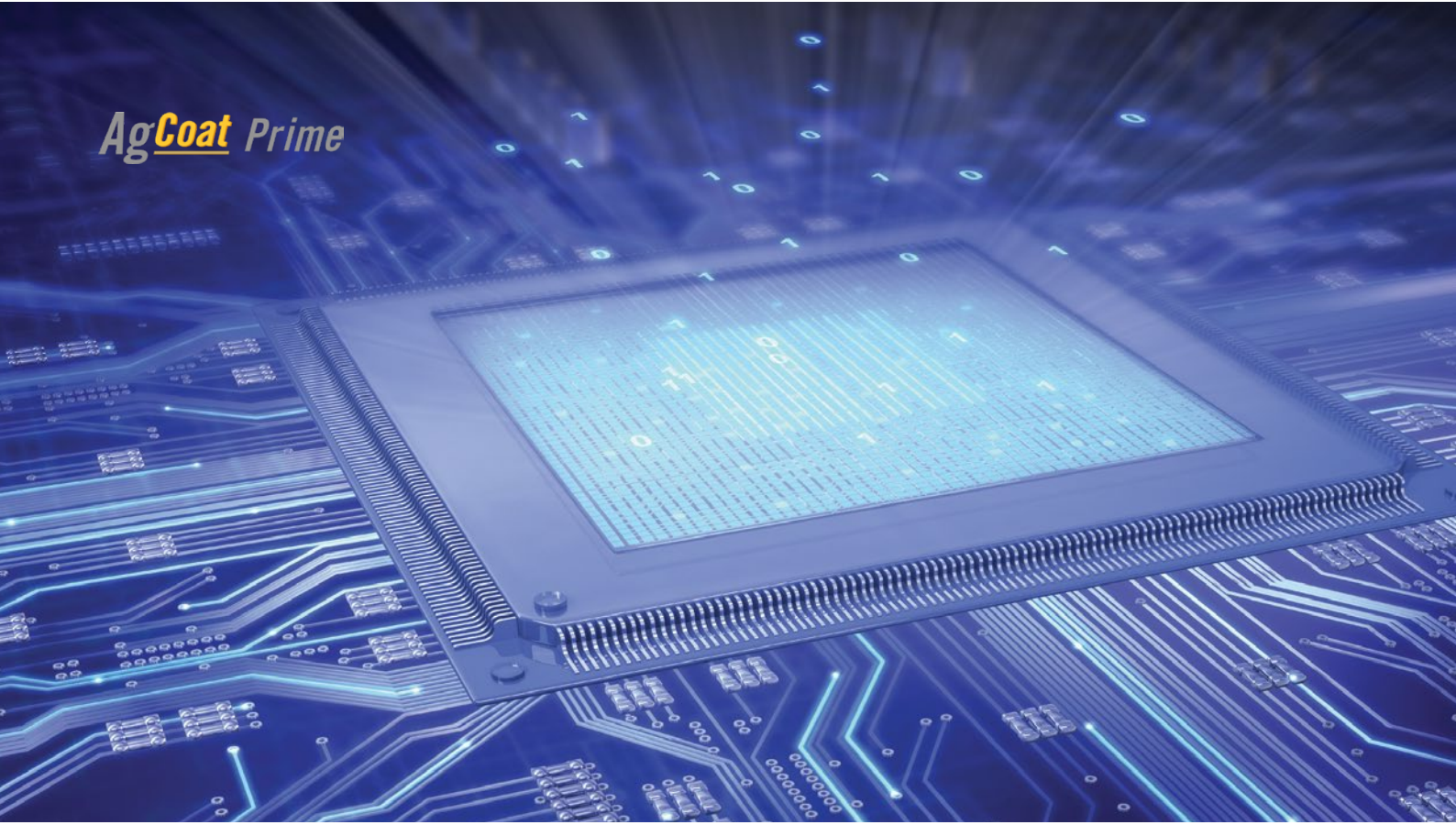


**AgCoat Prime**



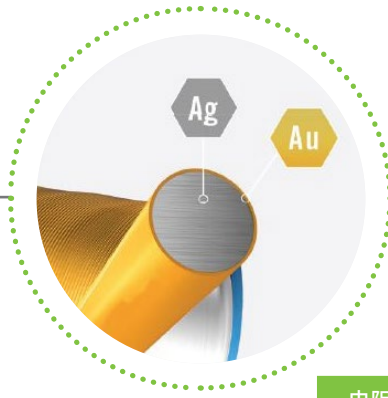
## AgCoat® Prime 完美的性价比

AgCoat® Prime是全球首款可真正替代金线的键合线，是存储器件领域的理想选择。AgCoat® Prime是一款表面镀金的银线。凭借独特的结构设计，该产品有助于客户降低成本、减少人力，并且更好地控制生产时间。

### AgCoat® Prime 的主要优势

- 键合过程中实现无惰性气体保护下烧球 (FAB)
- 与银合金线相比，使用寿命更长 (60天)
- 提高第二焊点的作业性
- 与金线相比，提高了高温存储 (HTS) 和温度循环 (TC) 的能力
- 利用客户现有生产设施，无需任何额外的固定资产投资
- 可以使用现有的键合机
- 金属间化合物 (IMC) 的生长比金线缓慢
- 与金线的MTBA有可比性 (最少4小时)

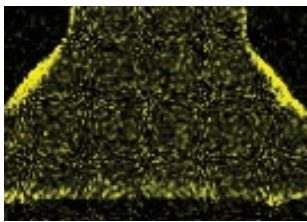




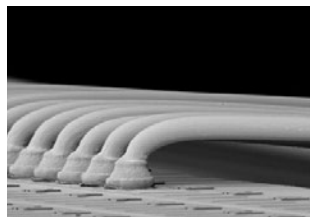
### 电阻率

### 熔断电流

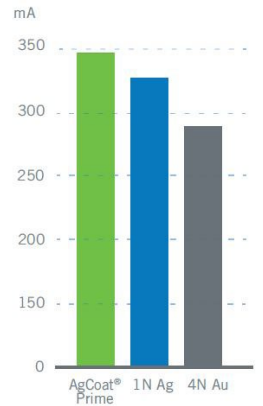
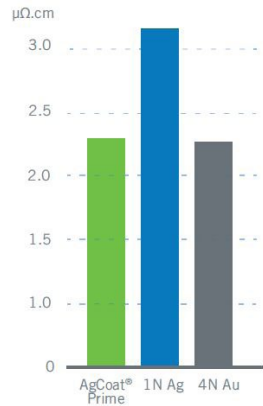
### 金覆盖和低线弧键合引线



金覆盖键合后的球



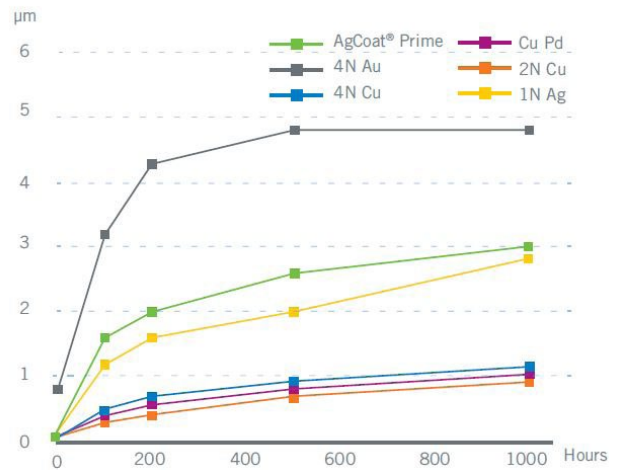
超低线弧高度不超过2.4mil, 不会出现颈部裂纹



### 优势/性能比较



### 金属间化合物生产



美洲地区  
电话 +1 610 825 6050  
electronics.americas@heraeus.com

亞太  
电话 +65 6571 7649  
electronics.apac@heraeus.com

中国  
电话+86 53 5815 9601  
electronics.china@heraeus.com

歐洲·中東和非洲  
电话 +49 6181 35 4370  
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本(可索要最新版本文件)尽管数据均准确无误,但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任(除非事先以协议的形式征得明确的书面同意)。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识, Heraeus, 贺利氏, 和AgCoat® Prime 图形标志是贺利氏控股有限公司或其附属公司的商标或注册商标。所有权利归贺利氏所有。